

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-009

# 深南电路股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	深南电路	股票代码	002916
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丽君	谢丹	
办公地址	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼	
传真	0755-86096378	0755-86096378	
电话	0755-86095188	0755-86095188	
电子信箱	stock@scc.com.cn	stock@scc.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （1）报告期内公司所处行业情况

深南电路成立于 1984 年，始终专注于电子互联领域，经过近 40 年的深耕与发展，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务。公司已成为中国印制电路板行业的领先企业，中国封装基板领域的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、印制电路板行业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会（CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。

目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放 PCB 供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。

**1) 印制电路板（含封装基板）行业发展情况**

根据 Prismark2022 年第四季度报告统计，2022 年以美元计价的全球 PCB 产业产值同比上升 1%。

从中长期看，产业将保持稳定增长的态势。2022 年-2027 年全球 PCB 产值的预计年复合增长率达 3.8%。从区域看，全球各区域 PCB 产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区复合增长率为 3.3%，增长保持稳健。从产品结构看，封装基板、HDI 板、18 层及以上的高多层板、8-16 层的高多层板仍将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为 5.1%、4.4%、4.4%、3.9%。

2022-2027 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

类型/年份	2021	2022E		2027E	2022-2027E
	产值	同比	产值	产值	复合增长率
美洲	3,245	3.8%	3,369	4,129	4.2%
欧洲	2,003	-5.9%	1,885	2,250	3.6%
日本	7,310	-0.4%	7,280	8,414	2.9%
中国大陆	44,143	-1.4%	42,553	51,133	3.3%
亚洲（日本、中国大陆除外）	24,207	5.9%	25,654	32,462	4.8%
合计	80,910	1.0%	81,740	98,388	3.8%

数据来源：Prismark 2022 Q4 报告

对于封装基板产品，5G 通信、人工智能、云计算、自动驾驶、智能穿戴、智能家居、万物互联等产品技术升级与应用场景拓展，驱动电子产业对芯片和先进封装需求的大幅增长，从而间接带动了全球封装基板产业的发展。

对于 PCB 产品，无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。伴随 5G 时代下物联网、AI、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现，各类终端应用也带来数据流量的激增，在下游电子产品拉升 PCB 用量的同时，也进一步驱动 PCB 向高速、高频和集成化、小型化、轻薄化的方向发展。高多层、高频高速、HDI 等中高阶 PCB 产品的需求将继续保持较好增长。

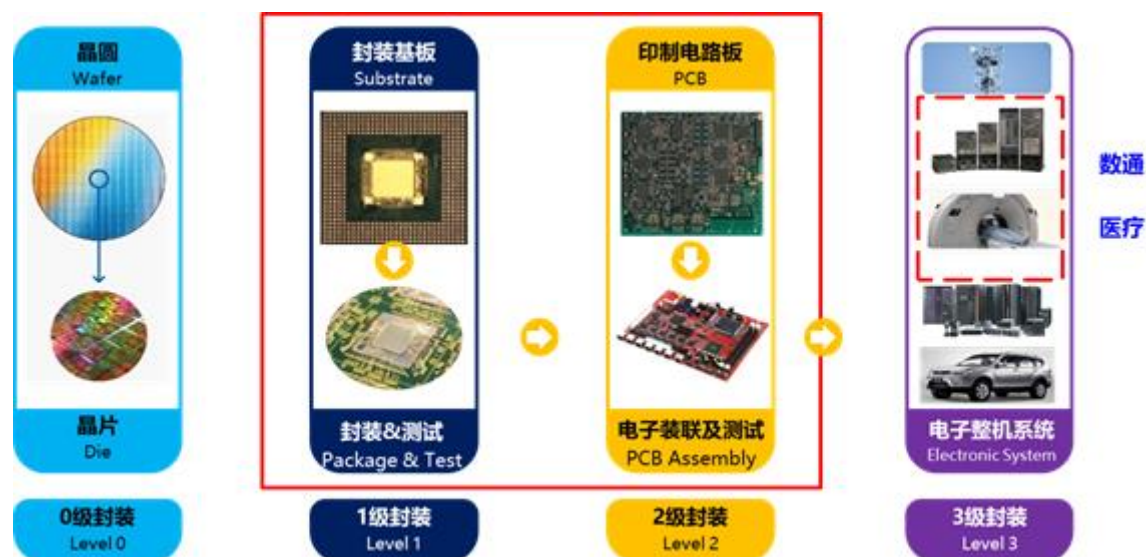
**2) 电子装联行业发展状况**

电子装联在行业上属于 EMS 行业，行业狭义上指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。目前全球 EMS 行业的市场集中度相对较高，国际上领先的 EMS 厂商均具备为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌、销售以外服务的能力。电子装联行业供应链较为复杂，涉及包括 PCB、芯片、主被动元件等在内的各种电子元器件，故供应链更容易受到上游零件短缺的冲击，因此供应链能力也逐渐成为电子装联行业的核心竞争力之一。

2022 年以来，全球多个国家、地区的防疫管控政策逐步放松，生产物流有所恢复，叠加下半年以消费电子为代表的终端需求下滑，电子产业的芯片与其他电子元器件供应环境整体上有所改善，但汽车与工控领域部分高端芯片结构性短缺仍然存在。

**(2) 报告期内公司从事的主要业务**

深南电路始终专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。公司以互联为核心，在不断强化印制电路板业务领先地位的同时，大力发展与其“技术同源”的封装基板业务及“客户同源”的电子装联业务。公司业务覆盖 1 级到 3 级封装产业链环节，具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，能够为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。封装基板、印制电路板和电子装联（含电子整机/系统总装）所处产业链环节如下图所示：



### 1) 印制电路板产品

印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）是指在覆铜板按照预定设计形成铜线路图形的电路板，其主要功能是使各种电子零组件按照预定电路连接，起电气连接作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。公司在印制电路板业务方面专业从事高中端印制电路板的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。

应用领域		主要设备	相关 PCB 产品	特征描述
通信	无线网	通信基站	背板、高速多层板、高频微波板、多功能金属基板	金属基、大尺寸、高多层、高频材料及混压
	传输网	OTN 传输设备、微波传输设备	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	核心网	路由器、交换机	背板、高速多层板、高频微波板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合、高频材料及混压
	固网宽带	OLT、ONU 等光纤到户设备	背板、高速多层板	多层板、刚挠结合
数据中心	交换机、服务器/存储设备	背板、高速多层板	高速材料、大尺寸、高多层、高密度、多种背钻、刚挠结合	
工控医疗	工控、医疗系统	高速多层板	高可靠性、多层板、刚挠结合	
消费电子	电池保护、光学摄像、无线耳机等	刚挠结合板、HDI	高密度、轻薄、立体组装、高可靠性	
汽车电子	毫米波雷达、激光雷达、摄像头、新能源汽车	高频微波板、刚挠结合板、厚铜板	高频材料及混压、高可靠性、HDI、刚挠结合、多层板、厚铜	

### 2) 封装基板产品

封装基板与 PCB 制造原理相近，是 PCB 适应电子封装技术快速发展而向高端技术的延伸，两者存在着一定的相关性。封装基板作为一种高端的 PCB，具有高密度、高精度、高性能、小型化及薄型化等特点，是芯片封装不可或缺的一部分，不仅能够为芯片提供支撑、散热和保护作用，也为芯片与 PCB 母板之间提供电气连接。

公司生产的封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，覆盖了包括半导体垂直整合制造商、半导体设计商以及半导体封测商等主要客户群，并与多家全球领先厂商建立了长期稳定的合作关系，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。

### 3) 电子装联

电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，具体指依据设计方案将无源器件、有源器件、接插件等电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在 PCB 上，实现电子电气的互联，并通过功能及可靠性测试，形成模块、整机或系统。公司电子装联产品按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、医疗电子、汽车电子等领域。目前公司已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。凭借专业的设计能力、扎实的技术实力、持续加强的智能制造能力、稳定可靠的质量口碑以及快速的客户响应，公司电子装联业务已与多家全球领先企业建立起长期战略合作关系。公司坚持深耕大客户策略，电子装联业务多年来始终保持稳定发展。

#### (3) 主营业务分析

2022 年，在国际形势多变、美元利率提升等多重因素影响下，全球经济复苏显著放缓。下半年以来，电子产业受经济环境影响较为显著，整体需求进一步承压。公司积极应对外部环境带来的挑战，通过优化产品结构、强化运营能力、提升生产经营效率，实现了全年利润的平稳增长。报告期内，公司实现营业总收入 139.92 亿元，同比增长 0.36%；归属于上市公司股东的净利润 16.40 亿元，同比增长 10.74%。

##### 1) 印制电路板业务稳定运营，持续优化产品布局

报告期内，公司印制电路板业务实现主营业务收入 88.25 亿元，同比增长 1.01%，占公司营业总收入的 63.06%；毛利率 28.12%，较去年同期提升 2.84 个百分点。

通信领域，2022 年国内通信市场需求放缓，海外通信需求上升。公司凭借行业领先的技术实力与高效优质的服务能力，在国内客户端份额保持稳定的同时，海外通信业务占比提升。从中长期看，国内与海外市场的通信基础设施建设需求持续存在，伴随通信技术及应用的不断拓展，整体市场具备发展前景。

数据中心领域，受产业需求走弱和 Intel Eagle Stream 平台服务器芯片发布延期的影响，2022 年下半年以来，公司数据中心领域订单短期承压。公司已配合主要客户完成新一代平台服务器 PCB 研发，现已逐步进入中小批量供应阶段，有能力快速满足客户后续大批量供应需求。

汽车电子领域，公司通过深耕大客户和开发新客户，确保了汽车电子领域订单继续保持稳定上升趋势，订单同比增长超 60%。同时，公司通过聚焦目标产品、强化内部运营、提升体系能力等举措有效增进了汽车电子业务的盈利水平。汽车电子专业工厂南通三期产能爬坡稳步推进、技术能力持续提升，年底已开始盈利。

报告期内，PCB 业务运营能力持续提升。公司一方面通过主动优化业务订单结构，提升高盈利产品占比；另一方面通过智能制造、工程设计优化等措施，进一步提高产品质量和工厂运营效率，进而有效提升了业务利润率，为公司利润增长带来贡献。

##### 2) 封装基板业务 FC-BGA 技术能力突破，工厂建设顺利推进

报告期内，公司封装基板业务实现主营业务收入 25.20 亿元，同比增长 4.35%，占公司营业总收入的 18.01%；毛利率 26.98%。

2022 年全球半导体景气逐步走弱，特别自下半年以来全球消费电子市场需求持续回落，对公司部分应用于消费领域的封装基板产品订单需求产生一定影响。报告期内，公司封装基板业务通过加强客户开发和技术能力建设，保障了全年营收相对稳定。

下游市场拓展方面，存储类产品因客户开发及深耕工作取得显著成效，保障了稳定的订单来源。FC-BGA 封装基板产品国内外客户开发导入工作持续稳步推进，相关产品目前已交付多家客户进行送样认证。

技术能力建设方面，公司 FC-CSP 封装基板产品在 MSAP 和 ETS 工艺方面达到行业先进技术能力；RF 封装基板产品取得了显著技术突破，实现了产品全系列覆盖；FC-BGA 封装基板已具备中阶产品样品制造能力，高阶产品技术研发按期顺利推进。此外，通过积极推动技术攻关等举措，封装基板业务进一步提升关键产品良率，有效降低了市场需求下行对业务利润造成的不利影响。

新项目建设方面，广州封装基板项目和无锡基板二期项目建设推进顺利。无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段。广州封装基板项目分两期建设，目前项目总体进展推进顺利，其中一期部分厂房及配套设施主体结构已封顶，预计将于 2023 年第四季度连线投产。

##### 3) 电子装联业务营收稳步增长，供应链管理能力的进一步提升

报告期内，公司电子装联业务实现主营业务收入 17.44 亿元，同比降低 10.08%，占公司营业总收入的 12.47%；毛利率

13.15%。

2022 年全球电子产业增长放缓，电子物料供应环境逐步改善，但汽车和工控等领域部分高端芯片的结构性短缺依然存在，电子装联业务在供应链层面依旧面临一定压力。公司积极应对外部环境变化，加大非通信领域客户的开发力度，在数据中心、工控医疗、汽车电子领域均取得相应突破。

内部运营层面，公司通过加强精细化管理，升级自动物流与生产自动化等降本增效措施，助力电子装联业务毛利率改善；通过强化供应链管理能力建设，提升客户对交付的满意度；通过提升前端辅助设计及后端增值服务能力，进一步加强对客户的一站式服务水平。

#### 4) 持续推进流程变革，深入实施数字化转型，促进内部精益不断改善

面对复杂外部环境带来的挑战，公司深入开展流程变革和数字化转型工作。报告期内，公司通过探索、实践先进的流程及管理理念，推动运营管理体系升级突破，逐步优化了管理流程体系；通过落实一系列数字化管理举措，打通管理平台与制造平台的数据链接，进一步提升质量管理能力和生产经营效率，促进内部精益持续改善。在数字化管理赋能下，公司在市场机会聚焦、制造过程优化、工艺技术突破、智能制造深化等方面实现高质量挖潜增效，保障了持续稳健运营，提升了盈利能力。

#### 5) 研发创新能力稳步提升，关键产品技术实现突破

报告期内，公司研发投入 8.20 亿元，同比增长 4.75%，占营业总收入的 5.86%。公司长期坚持技术领先战略，以技术发展为第一驱动力，高度重视技术与产品的研发工作，不断提升研发和创新能力。近年来，公司持续加大研发投入规模，研发投入占营收比重不断提升。报告期内，公司各项研发项目进展顺利，通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，以及 FC-BGA 类基板产品能力建设，FC-CSP 精细线路基板和射频基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。2022 年内，公司新增授权专利 141 项，新申请 PCT 专利 8 项，多项产品、技术达到国内、国际领先水平，获得各类科技奖励。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	20,726,545,628.78	16,792,291,128.17	23.43%	14,007,819,588.20
归属于上市公司股东的净资产	12,249,407,783.16	8,516,936,681.69	43.82%	7,441,079,748.97
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	13,992,454,035.04	13,942,521,948.74	0.36%	11,600,456,950.24
归属于上市公司股东的净利润	1,639,730,777.66	1,480,637,000.32	10.74%	1,430,111,325.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,498,362,669.88	1,271,642,082.90	17.83%	1,294,094,538.71
经营活动产生的现金流量净额	3,179,833,339.56	2,341,812,030.05	35.79%	1,799,999,047.12
基本每股收益（元/股）	3.22	3.02	6.62%	3.00
稀释每股收益（元/股）	3.21	3.01	6.64%	2.98
加权平均净资产收益率	14.70%	18.70%	-4.00%	23.86%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,315,538,479.51	3,656,078,343.95	3,513,788,312.78	3,507,048,898.80
归属于上市公司股东的净利润	347,845,453.43	404,255,239.62	429,680,330.46	457,949,754.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,278,699.39	375,848,807.60	397,981,072.42	400,254,090.47
经营活动产生的现金流量净额	610,048,806.83	1,022,223,449.16	798,774,334.49	748,786,749.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,453	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中航国际控股有限公司	国有法人	63.97%	328,068,670	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.78%	14,249,380	0			
李雪红	境内自然人	0.58%	2,990,000	0			
国新投资有限公司	国有法人	0.57%	2,942,109	0			
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	0.54%	2,787,585	0			
华润深国投信托有限公司—华润信托·淡水泉平衡 5 期	其他	0.52%	2,668,656	0			

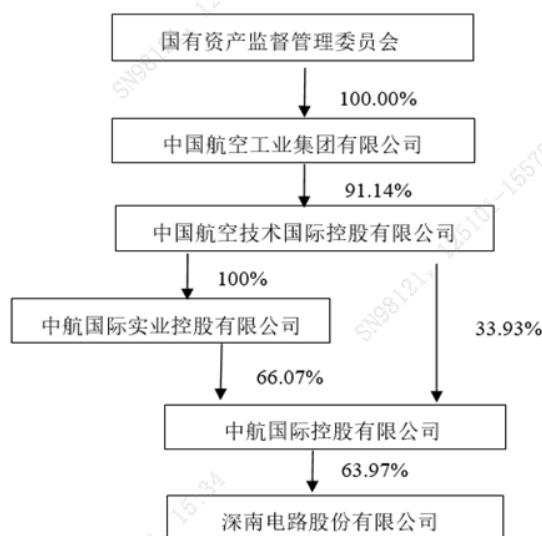
集合资金信托计划						
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.52%	2,666,438	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.42%	2,176,900	0		
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	0.41%	2,118,838	0		
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉全球成长 1 期私募证券投资基金	其他	0.39%	2,008,616	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李雪红通过信用交易担保证券账户持有 2,990,000 股，实际合计持有 2,990,000 股					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

2022 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号），核准公司非公开发行不超过 146,762,481 股新股，详情请见公司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2022-001）。

本次非公开发行新增股份数 23,694,480 股，发行价格 107.62 元/股，募集资金总额为 2,549,999,937.60 元，扣除各项不含税发行费用人民币 20,335,154.66 元后，本次募集资金净额人民币 2,529,664,782.94 元。该等股份已 2022 年 2 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，2022 年 2 月 24 日在深圳证券交易所上市。详情请见公司于 2022 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》。